

**中信证券股份有限公司**  
**关于深圳市力合微电子股份有限公司**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2022 年 8 月 16 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅《2023 年度内部控制评价报告》、2023 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与主要股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总评价报告表的专项审计报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### (一) 核心竞争力风险

#### 1、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司采取了严格的保密措施，也和核心技术人员签署了保密协议，并通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

#### 2、核心技术人才流失风险

集成电路设计行业涵盖硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业，公司作为集成电路设计企业，对于专业人才尤其是研发人员的依赖远高于其他行业，核心技术人员是公司生存和发展的重要基石。一方面，随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于高端人才的竞争也日趋激烈。另一方

面随着行业竞争的日益激烈，企业与地区之间人才竞争也逐渐加剧，公司现有人才也存在流失的风险。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失、技术失密的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

## （二）经营风险

### 1、电网采购需求周期性波动风险

报告期内，公司产品主要应用于电网市场。受到建设周期和技术迭代影响，电网市场对于电力线载波通信产品的需求具有一定的周期性。第一轮大规模采购周期从 2009 年开始至 2017 年结束，第二轮大规模采购周期从 2018 年四季度开始，目前正处于建设初期，采购周期的变化将会对公司业绩产生影响。未来，如果由于技术发展，公司没有设计出符合下一轮采购周期的产品，或者两轮大规模采购周期之间的过渡期较长导致市场没有足够采购需求，且届时公司收入结构仍主要依赖于电网市场，则公司业绩可能受到电网市场需求周期性波动影响而下滑。

### 2、原材料及代工价格波动风险

公司作为 Fabless 芯片设计企业，具有轻资产属性，芯片产品及应用方案产品采用代工生产模式，自身不具有生产能力。主要采购的原材料和代工服务可能受各种因素影响产生较大价格波动，若晶圆、辅助 IC、电容、PCB 板等主要原材料的价格受宏观经济形势、国际贸易形势及市场供应形势等因素影响而大幅上涨，或模块及整机代工价格受人工成本、能源成本、工期以及季节性因素影响而大幅上涨，而公司未能通过提高产品销售价格和销售规模抵消原材料与代工价格上涨的影响，公司业绩将可能因此受到影响。

### 3、营业收入季节性波动风险

公司产品主要面向包含电网市场在内的各类物联网应用领域，虽然非电网市场销售不断增长，但电网市场收入仍为总营收的主要组成部分。公司在电网市场领域的客户主要为国内各智能电表生产企业和电网公司，产品最终用户大部分为电网公司。因行业特性及终端客户性质，终端客户多执行严格的预算管理制度和

采购审批制度，项目的实际执行按照计划进行，营业收入呈现出一定的季节性波动特点。

#### 4、市场需求预测风险

由于订单交付周期短于产品的生产周期，公司产品的采购与生产计划高度依赖于对市场需求情况的预测与判断。在电力物联网领域的应用需求高速增长的过程中，为迅速响应市场需求，公司在备货过程中需要在历史数据的基础上预测一定程度的增量以满足客户的需求。若客户需求转向或市场需求增长停滞，可能会导致存货产生一定程度的积压，一方面造成公司的资金压力，另一方面若最终无法实现销售，将对公司业绩产生不利影响。

#### 5、产品认证未能续期的风险

公司相关产品在国网和南网市场销售需取得国网计量中心有限公司和南方电网科学研究院有限责任公司实验检测中心的认证。若未来相关认证未能续期或者公司研发的新产品或者公司研发的新产品未能通过相关认证，则存在公司未获认证的产品无法在相应市场进行销售的风险。

#### 6、经营业绩波动风险

2020 年公司业绩曾经受到影响。未来在电网市场建设与采购周期、宏观经济环境、外部竞争环境、原材料与人工成本等因素发生重大不利变化的影响下，公司将存在经营业绩波动的风险。

#### 7、非电网市场业务开拓风险

公司技术和芯片产品相关的非电网物联网的应用可分为消费类应用（如智能家居控制）、工业类应用（各种非电网应用场景下的智能控制、大数据采集、智慧能效管理、远程监测等）和垂直行业类应用（高铁能效管理、路灯控制、多表抄收等）。其中垂直行业应用受行业内权威企业或组织（如电网市场中的国网和南网）统一组织、部署、相关标准规范制定的影响，非电网市场仍未建立起统一的互联互通标准，导致非电网市场应用规模和启动时间具有不确定性。公司已通过技术宣导、方案测试、样品测试等多种方式，在智慧光伏、电池管理、智能家居、路灯控制、能效管理、景观控制、多表集抄等非电网领域推广自身产品和方

案。但受制于市场发展阶段,存在公司投入资金和技术资源大力开发非电网市场,但相关市场开拓达不到预期成果、PLC 技术方案作为一种比较新的技术方案未能获得下游客户的广泛认可的风险。

### **(三) 财务风险**

随着公司经营规模不断扩大,公司应收款项余额也相应增长。公司直接客户主要为电网公司、电表企业和模块厂商等,终端客户主要为电网公司,主要客户信誉良好,历史发生坏账的情形较少。但如果未来主要客户经营情况发生重大不利变化,将会影响公司应收账款的正常回收,公司将面临应收账款无法收回的风险,从而对公司经营活动净现金流量和经营业绩产生不利影响。

### **(四) 行业风险**

#### **1、市场竞争风险**

公司产品所在市场的参与者主要包括与公司产品相同或相似的部分国内芯片设计公司以及部分具有市场、资金及技术优势的境外知名企业。北京智芯微电子在电网市场上具有优势,华为海思在技术上、资产规模及抗风险能力上具有一定优势。还有其他 IC 设计公司不断进入该领域,市场竞争日趋激烈,或将加剧公司面临的市场竞争风险,对公司未来经营业绩产生不利影响。

#### **2、市场政策风险**

公司所处物联网行业涉及的行业主管部门主要包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、市场监督管理总局、住房和城乡建设部及各具体应用行业的主管部门,涉及法规政策众多。目前,公司严格按照行业法规政策及行业标准进行生产经营。但是物联网行业发展迅速,各应用行业发展不平衡且具有一定的定制化特点,如果物联网下游应用行业的相关法规政策及行业标准发生变化且公司未能及时对产品研发及生产、产品类别及质量标准进行相应调整,则将可能对公司未来的生产经营构成不利影响。如果行业发展不达预期或市场需求下滑,将导致公司所处细分行业发展放缓,从而影响公司的快速成长。

### **(五) 宏观环境风险**

## 1、国际政治及贸易变化的风险

作为一家典型的 Fabless 集成电路设计行业，公司并不自行组织生产，而是向代工厂采购生产服务以完成产品生产。中国和美国目前存在贸易争端，互相采取了关税壁垒、政府管制等方式进行应对，若未来贸易争端扩大化，对中国半导体行业的封锁日益加重，代工行业产能受阻，则可能对公司的经营成果产生不利影响。

## 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	57,918.82	50,382.29	50,382.29	14.96
归属于上市公司股东的净利润	10,688.66	7,513.56	7,507.31	42.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,278.91	5,354.15	5,347.90	73.30
经营活动产生的现金流量净额	27,277.20	-4,737.69	-4,737.69	675.75
主要会计数据	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减（%）
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	100,896.24	81,652.90	81,637.64	23.57
总资产	144,398.80	103,656.89	103,444.08	39.30
主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	1.07	0.75	0.75	42.67
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.75	0.75	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.93	0.54	0.53	72.22
加权平均净资产收益率	11.90	9.65	9.64	增加2.25个百

(%)				分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.33	6.87	6.87	增加3.46个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.15	15.45	15.45	减少1.30个百分点

1、2023 年公司实现营业收入 57,918.82 万元，较上年同期增长 14.96%，主要原因系公司芯片在智能电网市场的应用不断深化，公司加大推广和应用，市场业绩持续增长，同时公司芯片在其他物联网市场的应用也较快增长。截至 2023 年底，在手订单金额为 26,216.87 万元（包括已签合同金额及中标金额），较上年同期增长 22.75%；本期收入和在手订单均有增长。

2、2023 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较 2022 年分别增加 3,175.10 万元、3,924.76 万元，分别增长 42.26%、73.30%。主要原因系公司订单增加，收入增长；同时对比上年同期，公司回款有较大增加，成本费用控制较好，因此净利润及扣除非经常性损益的净利润都有较大幅度增长。

3、2023 年经营活动产生的现金流量净额，较 2022 年增长 675.75%，主要系营业收入增长，回款增加，应收票据及应收款项融资到期收款增加，经营活动产生的现金流入有大幅增长所致。

4、2023 年总资产，较 2022 年增长 39.30%，主要系公司发行可转债及净利润增加所致。

5、2023 年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，较 2022 年分别增长 42.67%、72.22%，主要系净利润增长所致。

6、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——

所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、深厚的技术积累，强有力的研发团队和持续研发创新能力

##### （1）基于深厚的 PLC 技术积累，助力公司物联网核心竞争力

公司在 PLC 技术和芯片领域 21 年长期、专注的研发、品牌建设和市场应用，使得公司在当今的物联网市场中突显竞争优势。在电力线通信及物联网 SoC 通信芯片领域，企业的核心竞争力在于自主核心技术上的持续研发，包括数字通信基础理论、算法技术、路由算法技术等基础技术，以及 CPU 设计技术和数模混合超大规模集成电路设计技术等。公司在 PLC 技术和芯片领域具有种类多样的自研芯片、丰富的应用经验、和多种完整解决方案，公司也是多项相关国家标准的主要起草单位。

##### （2）研发团队经验丰富，研发创新能力较强

以 LIU KUN 博士为领军人的公司技术团队在电力线通信及物联网通信及芯片设计领域积累了多年的研发技术和经验。LIU KUN 博士 1992 年获荷兰代尔夫特（Delft）大学电气工程博士学位，在 CDMA 移动通信研究、无线通信系统研发、OFDM 数字通信技术研究、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发等技术领域有着 30 多年的研发及项目管理和团队经验，作为执笔人起草了电力线通信国家标准 GB/T31983.31-2017《低压窄带电力线通信第 31 部分：窄带正交频分复用电力线通信物理层》。公司研发团队其它核心技术人员在数字通信技术、数字信号处理、数模混合超大规模芯片设计技术领域、或应用方案开发上也拥有 20 年以上的经验和技术积累。

公司面向电力物联网和非电物联网应用领域推出系列产品及方案。面向电力物联网，量测开关模组产品、光伏协议转换器产品等创新应用产品形成批量订单；面向非电力物联网，面向智能家居、智慧照明、智慧光伏、智慧酒店等领域，均推出创新的产品及方案，并形成落地订单。



## 2、专注物联网通信技术领域，深度参与相关标准制定

公司自成立以来，长期专注、致力于物联网通信和芯片设计基础及自主核心技术和底层算法研发并注重技术创新。针对国内电网环境，公司在国内电力线通信上应用过零传输 OFDM 技术（Z-OFDM）并推出高集成度 SoC 专用芯片，同时也是国网及南网高速电力线通信标准制定及高速双模通信标准制定的核心参与企业。除了电力线通信主芯片系列产品在市场上大规模应用外，公司所新推出的电力线通信线路驱动芯片也处于市场领先地位，可实现完全替代市场上使用的国外芯片，实现智能电网芯片完全国产化。报告期内，公司作为 IEEE1901.3 工作组成员，积极参与国际标准的制定，基于国内自主知识产权实现 HPLC 双模通信技术的国际化。

2019 年 6 月 10 日公司在广州国际建筑电气技术及智能家居展（GEBT）新品发布会上，首次发布面向开放物联网应用的电力线传输协议 PLBUS 协议。PLBUS 协议基于国内自主知识产权的电力线通信技术，该技术基于 MESH 网络技术、实现节点间对等通信，具有“无需布线、有电即通信、低延迟、高可靠性”等特点。经过多年技术营销、品牌营销、市场推广、客户应用，PLBUS 技术已逐渐被行业所接受。

报告期内，进一步巩固并提升了公司在物联网电力线通信领域的市场基础。公司推出 HPLC+HRF 高速双模芯片，该芯片也可以广泛应用于物联网各种应用；面向光伏新能源智能管理应用，推出符合北美 NEC2017（690.12）要求光伏发电系统实现“组件级控制”的 SUNSPEC PLC SOC 芯片以及能够支持光伏组件发电信息采集的双向通信 PLC SOC 芯片，基于该芯片的光伏组件快速关断模组率先通过了国际 CSA 检测认证机构认证，获颁发符合光伏组件级快速关断 SunSpec 通信规范测试认证证书。同时，在综合能效管理、智能家居、智慧城市路灯电力线通信国家标准制定及市场开拓、并开始进入智能电源数字化管理（电动车智能充电、智能电池管理）等应用领域，这些都为公司产业生态建立和业务发展打下优势基础。

## 3、打造可持续供应链，为公司可持续发展助力

### （1）推动供应链的可持续发展

公司不断加强供应链体系的管理，对内深入挖潜，控制成本，2023年，公司基于自研芯片及核心技术的产品库存量较上年减少了49.62%；对外多年来一直与芯片生产、封装、测试等企业建立长期稳定的合作关系，共同推动可持续供应链的发展。

### **(2) 提供高品质、高性能的产品**

芯片和模块的产品质量和性能不仅仅决定于生产代工环节，更决定于初始的芯片设计环节。即使是遵循统一的检测标准，但每家芯片原厂的设计工艺和设计水平的差异，也导致了其芯片和基于芯片的模块的质量有所差异。受益于长期专注于核心基础技术和底层算法的研发以及具备自主设计能力的研发团队，公司产品质量可靠、性能优异，产品认可度持续提高。同时通过技术创新降低产品能耗，延长产品使用寿命，减少资源浪费。

### **(3) 持续强化技术服务体系**

公司作为电力线通信技术和芯片原创设计企业、国家标准主要起草单位，植根智能电网应用市场已有十数年，深刻了解客户需求和应用需求，积累了丰富的经验。公司持续强化专业技术服务支撑体系，快速响应客户售前及售后各类技术服务需求，客户认可度显著提升，公司的市场竞争力进一步加强，营业收入持续增长。

## **4、前瞻技术和市场布局，打造品牌领先优势**

公司在总经理、技术带头人 LIU KUN 博士的带领下，在技术、产品、市场等各方面前瞻布局，充分利用在电网市场 10 多年的上亿规模应用经验，全面规划在电力物联网、智慧光伏和智慧电源等新能源智能管理、高铁智能用电管理、智能家居、智能酒店客控市场等物联网业务领域的技术路线、产品研发、市场拓展工作，发挥先发优势，树立品牌竞争力。

### **(二) 核心竞争力变化情况**

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	6,558.31	7,329.93	-10.53
资本化研发投入	1,639.06	454.21	260.86
研发投入合计	8,197.37	7,784.14	5.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	14.15	15.45	减少 1.30 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	19.99	5.84	增加 14.15 个百分点

2023 年度，公司研发投入总额较 2022 年度增长 5.31%，未发生重大变化。

在持续督导的过程中，保荐人关注到，2023 年度公司研发投入资本化的金额为 1,639.06 万元，资本化金额较以往年度有较大增长；根据对公司管理层以及年审会计师的访谈，并经公司确认，主要原因系报告期内新增部分产品类开发项目满足资本化条件进入开发阶段，同时公司持续加大产品化研发项目投入。保荐人将在后续持续督导过程中，持续关注并与会计师共同督促发行人按照《企业会计准则》的相关要求，进一步优化、完善、规范研发支出资本化的内控制度及流程等。

## （二）研发进展

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司研发费用明细、大额研发支出凭证、研发项目进展相关资料，查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，了解公司研发支出及研发进展情况。

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	6,421.00	222.34	6,030.26	项目已经完成预期目标并已结项。项目所研发芯片已经批量供货，现场应用达千万级别	研发多领域、多标准、高性能、高速率 SoC 芯片，以及相关的应用方案，并进行产业化	本项目采用先进的算法方案、芯片架构和工艺，处于国内领先水平	广泛应用于国内外以高速电力线载波为通信连接方式的物联网应用领域
2	微功率无线通信芯片研发及产业化项目	5,046.00	231.08	5,340.06	项目已经完成预期目标并已结项。本项目所研发的芯片已经实现量产销售	研发适合大规模应用的低功耗无线通信芯片以及相关的应用方案，并进行产业化	本项目采用先进的算法方案、芯片架构和工艺，处于国内领先水平	广泛应用于智慧城市、智能家居、能源管理、公共安全、智慧楼宇、电力、军事工业等行业，为智能设备提供一种高性能无线传感和数据传输技术和芯片方案，实现万物互联
3	基于自主芯片的物联网应用开发项目	6,674.00	1,236.37	7,808.86	项目已经完成预期目标并已结项。项目研发物联网相关的产品方案，为物联网的市场开拓提供	基于自主芯片，为物联网应用提供有竞争力的应用方案	基于自主芯片的物联网应用方案性能、成本、客户导入速度	广泛应用于酒店、公寓等智能控制领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					有竞争力的产品。智慧照明产品方案、智能家居产品方案等均已开始批量供货		等均具有良好的竞争力，处于国内领先水平	
4	新一代北斗多模多制式导航核心芯片研发	1,800.00	77.67	1,654.81	已完成新一代北斗多模、多制式导航芯片的算法设计、芯片 RTL 设计和 FPGA 验证。项目已验收结项	研发新一代北斗多模、多制式导航核心芯片算法及验证	本项目采用先进的算法方案、芯片架构和工艺，处于国内领先水平	广泛应用于智能城市建设、交通运输、物联网应用、电力应用、大众应用等领域的应用领域
5	智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产业化项目	21,631.47	2,208.98	2,392.72	智慧光伏北美 sunspec 专用 PLC 芯片研发项目已完成系统方案设计、电路设计和验证，正在开展后端实现和模拟版图设计。光伏监测快速关断驱动芯片研发项目已完成电路设计，正开展版图设计和后仿真	研发适用于国内和国外智慧光伏管理、电池管理等领域的系列 PLC 控制芯片及产业化	本项目采用先进的算法方案、芯片架构和工艺，处于国内领先水平	广泛应用于光伏发电、新能源汽车等新能源行业的智能化管理、控制、监测、数据采集、运维等领域
6	智能家居多模通信网关及智能设备 PLC 芯片研发及产业化项目	17,672.24	2,606.62	2,812.04	智能设备 PLC 芯片研发项目完成流片，回片测试通过，各项性能表现优异，高集成度、低 BOM 成本、具有很高竞争力，已开展应用方案研发，芯片近期开始小批量量产	研发应用于智能家居领域及智能照明领域的 PLC 网关及 PLC 控制等系列芯片，并推进产业化	本项目采用先进的算法方案、芯片架构和工艺，处于国内领先水平	广泛应用于家庭及公共场所环境下各类电子设备的智能通信连接与控制等物联网应用领域
7	智能家居和智慧光伏应用方案 1.0	470.00	472.81	472.81	已完成智能家居多模网关应用方案，智慧光伏应用方案的研发	研究基于 2022 年公司已有芯片应用于智能家居、智慧光伏等领域的	本项目是围绕智能家居，智慧光伏等行	广泛应用于智能家居、智慧光伏等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					工作，进入市场推广阶段。项目已验收结项	应用软件方案	业的痛点，研发有竞争力的应用方案，处于国内领先水平	
8	物联网现场工具产品研发项目	290.00	394.17	394.17	已形成 PLC 中继器等物联网工具产品，正在市场推广。	研发适用于物联网应用场景的工具产品	本项目基于自主研发芯片开发，处于国内领先水平	广泛应用于智能家居，智慧照明等物联网应用领域
9	智慧酒店项目	235.00	141.84	141.84	已完成第一代酒店智能客控产品开发，并经过多家酒店现场供货落地商用，并实现批量供货	基于自主芯片，为智慧酒店应用提供有竞争力的应用方案，并实现产业化	(1) 实现简便的控制；(2) 传感器采集，智能控制(3) 根据各种环境、习惯、人等，进行自动的智能控制	广泛应用于酒店、公寓等智能控制系统
10	双模载波芯片可靠性验证项目	350.00	346.61	346.61	已完成双模芯片可靠性验证项目，经过多批次大样本验证实验和制造工艺优化改进，确认该产品在工业应用各种场景下均能达到高可靠性水平。项目已验收结项	实验研究该芯片产品在各种工业应用环境下芯片的可靠性、寿命和一致性，通过实验数据统计分析制造工艺的精确性、稳定水平、波动因素及影响，从而对工艺进行优化改进，确保大批量制造的产品能够满足工业应用严格的品质要求	本项目实验测试条目参照 JESD22，JS-002-2022，MIL-STD-883L 等国际/行业标准规范选取，使用先进的实验设备和测试仪器，实验测试结果精确、结论可靠	该项目用于确保大批量制造的产品在各种工业应用环境下均能满足严格的寿命、品质要求
11	智慧城市物联感知系统	395.00	258.86	258.86	已完成能源数据集中器终端、能源数据采集器、融合终端的软硬	研究并开发智能电网、智慧城市等领域的智能终端，并承载智慧城市	本项目是围绕智能电网、智慧城市等领域	广泛用于智能电网、智慧城市等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					件设计、样机制作和小批生产，获得了国家电网检测机构的检测合格报告，并进行了现场试点	发展的需求增长，如能源数据集中器终端、能源数据采集器等	域的痛点，研发有竞争力的产品，处于国内领先水平	
合计		60,984.71	8,197.37	27,653.06				

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

保荐人对持续督导期间公司募集资金使用等情况进行核查，公司在 IPO 及可转债募投项目实施期间存在使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目相关费用，包括工资、社保费用、住房公积金、材料费、差旅费及房租物业费等。为了进一步加强募集资金使用的管理，公司针对该事项于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》，公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

力合微无控股股东和实际控制人。截至 2023 年 12 月 31 日，力合微董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：



单位：万股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
LIU KUN	董事长、总经理	829.00	829.00	-	/
刘元成	董事、副总经理	290.00	290.00	-	/
冯震罡	董事	315.12	268.12	-47.00	减持
罗宏健	董事	-	-	-	/
SUYANDONG	董事	-	-	-	/
黄兴平	董事	45.60	46.80	1.20	股权激励归属
	副总经理				
李忠轩	独立董事	-	-	-	/
常军锋	独立董事	-	-	-	/
陈慈琼	独立董事	-	-	-	/
王慧梅	职工代表监事、监事会主席	-	-	-	/
曹欣宇	监事	-	-	-	/
艾迎春	监事	-	-	-	/
吴颖	董事会秘书、副总经理	170.00	170.00	-	/
高峰	副总经理	0.60	1.80	1.20	股权激励归属
陈丽恒	副总经理	15.70	13.15	-2.55	减持
	核心技术人员				
钟丽辉	副总经理	20.40	5.48	-14.92	减持
张志宇	副总经理	0.50	1.50	1.00	股权激励归属
	核心技术人员				
李海霞	财务总监	23.16	3.00	-20.16	减持
贺臻（离任）	董事长	-	-	-	-
别力子（离任）	董事	-	-	-	-
沈陈霖（离任）	董事	333.33	333.33	-	-
周世权（离任）	财务总监	0.60	1.80	1.20	股权激励归属
<b>合计</b>		<b>2,044.01</b>	<b>1,963.98</b>	<b>-80.03</b>	<b>/</b>

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事冯震罡先生持有公司股份 268.12 万股，其所持股份质押 200.00 万股。

除上述情况外,公司董事、监事及高级管理人员在任职期间不存在其他质押、冻结及减持情况。

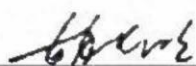
#### 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

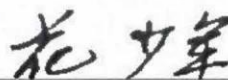
(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于深圳市力合微电子股份有限公司  
2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



胡跃明



花少军

